

# N800AH-s

## ノンシリコン熱伝導シート

LiPOLY N800AH-s はノンシリコン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサの揮発は少ないので、電子回路接点不良という状況はなりません。N800AH-sは良い熱伝導性があって、熱伝導率は  $7.0 \text{ W/m}^2\text{K}$  です。熱抵抗も低いて、光学製品や敏感な電子部品の使用には適合です。

### ■ 製品の特長

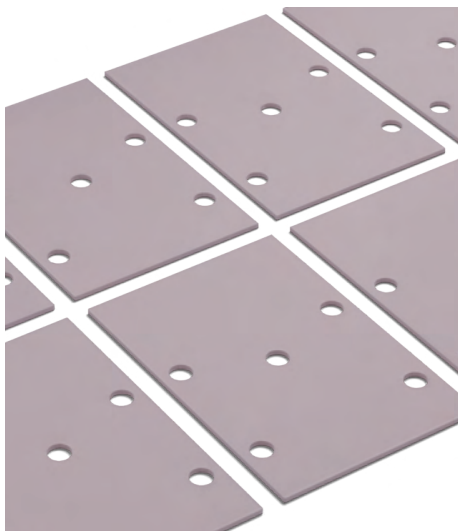
/ 熱伝導率:  $7.0 \text{ W/m}^2\text{K}$   
/ ノンシリコン材料  
/ 接触熱抵抗が小さい  
/ 電気絶縁  
/ 優れる熱伝導率  
/ 光学デバイスに適合

### ■ 製品アプリケーション

/ ハードディスク  
/ 光学デバイス  
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)  
/ 電気自動車

### ■ 製品の形

/ シート状  
/ フォーミング形



### ■ 代表特性

| 物理特性                | N800AH-s   | 試験方法               | 単位                     |
|---------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 色                   | Pink       | Visual             | -                      |
| 表面粘着性 (2面 / 1面)     | 2          | -                  | -                      |
| 厚さ                  | Customized | ASTM D374          | mm                     |
| 密度                  | 3.3        | ASTM D792          | g/cm <sup>3</sup>      |
| 硬さ                  | 60         | ASTM D2240         | Shore OO               |
| 使用温度                | -60~125    | -                  | °C                     |
| 低分子シロキサン (D3~D20合計) | N.D        | Gas Chromatography | %                      |
| 脱ガス CVCM (wt%)      | 0.0057     | By LiPOLY          | -                      |
| ROHS & REACH        | Compliant  | -                  | -                      |
| 圧縮特性@1.0mm          |            |                    |                        |
| 圧縮率 @10 psi         | 15         | ASTM D5470 modify  | %                      |
| 圧縮率 @20 psi         | 40         | ASTM D5470 modify  | %                      |
| 圧縮率 @30 psi         | 67         | ASTM D5470 modify  | %                      |
| 電気特性                |            |                    |                        |
| 絶縁破壊電圧              | 8          | ASTM D149          | KV/mm                  |
| 表面抵抗率               | $>10^{11}$ | ASTM D257          | Ohm                    |
| 体積抵抗率               | $>10^{10}$ | ASTM D257          | Ohm-m                  |
| 熱特性                 |            |                    |                        |
| 熱伝導率                | 7.0        | ASTM D5470         | W/m <sup>2</sup> K     |
| 熱抵抗@10 psi          | 0.274      | ASTM D5470         | °C-in <sup>2</sup> / W |
| 熱抵抗@20 psi          | 0.182      | ASTM D5470         | °C-in <sup>2</sup> / W |
| 熱抵抗@30 psi          | 0.121      | ASTM D5470         | °C-in <sup>2</sup> / W |

環状ポリジメチルシロキサン ( $\text{HO}[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{H}$ ) は、化学反応が起こっていない状態でも、常温環境下で容易に揮発します。たとえば、密閉された電子機器内部では、低分子シロキサンが揮発して電子接点に付着し、接触不良を引き起こすおそれがあります。

### 熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率

